

## 导热灌封硅胶 RH-TCP-1157

## 特色:

- 双组分导热硅凝胶
- 低硬度，低模量，低应力，高回弹
- 加成体系，耐高温，无小分子释放
- 常温固化或加热加速固化
- 低挥发分，挥发性环体<300PPM
- 高热稳定性，耐热冲击循环

## 产品组成

- 硅凝胶
- 无机导热填料

## 产品应用

- 通用性导热凝胶，灌封，如计算芯片，服务器等。
- 集成电路模块 PCB 导热

## 常见性能参数\*

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 产品名称              | RH-TCP-1157           |
| 导热率（瞬态法）W(m·K)    | 1.0                   |
| 硬度 Shore A        | 25-35                 |
| A 组分粘度，mPa.s      | 2500 ± 500            |
| B 组分粘度，mPa.s      | 2800 ± 500            |
| 单/双组分             | 双（1: 1） 灰/白           |
| 混合后密度 g/m         | 1.7 ± 0.1             |
| 击穿电压，KV/mm        | ≥20                   |
| 体积电阻率 Ω·cm        | ≥1.0*10 <sup>14</sup> |
| 可操作时间 min, 25° C  | 30-60                 |
| 初步固化时间 min, 25° C | 80-120                |

## 应用方法

- 自动点胶机

## 固化条件

- 运输储存过程会有少量沉淀，在使用前需预先进行搅拌
- 初固：常温 1.5-2 小时
- 固化： 常温 24hr 或加热固化（e.g. 60 摄氏度 1hr, 100 摄氏度 0.5hr）

## 运输储存条件

## 双组分包装:

- 200L 铁桶包装
- 低于 45 摄氏度运输
- 常温保存，最佳使用期限为 3 个月以内

### 产品应用温度

通常有机硅材料在很大温度范围内保持稳定，考虑到综合性能和老化影响，此系列 -25 至 150 摄氏度范围内使用可获得最佳效果。如需其他温度范围，请咨询应用工程师。

### 其他注意事项

- 
- 使用表面需保持清洁
- 工艺过程避免接触 N, S, P 等杂质
- 如需返工，再次使用前需清洁表面
- 点胶和涂胶过程中应避免气泡
- 避免人体皮肤直接接触